

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2026年5月7日-5月12日)

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>专场机构交流会 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他 <u>2025年年度股东会</u></p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>1、现场出席/列席 2025 年年度股东会的股东/股东代理人 2、参与 2026 年 5 月 12 日调研活动的投资人（见附件）</p>
<p>会议时间</p>	<p>2026 年 5 月 7 日 14: 00-16: 00 2026 年 5 月 12 日 9: 30-10: 30 2026 年 5 月 12 日 15: 00-16: 00</p>
<p>会议地点</p>	<p>2025 年年度股东会现场 佰维存储三楼会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长 孙成思 总经理 何瀚 董事会秘书兼财务负责人 黄炎烽 战投部总监兼投资者关系负责人 肖博天 证券事务代表 李帅铎 董办工作人员</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>Q1. 公司 2025 年分红金额约 1 亿元，后续能否加大分红力度？ A1: 根据公司披露的《2025 年年度利润分配预案的公告》，2025 年公司现金分红金额约为 1.00 亿元（含税），现金分红金额占合并报表归母净利润的比例为 11.72%；此外，公司 2025 年以现金方式回购股份并注销的金额约为 1.50 亿元（视同现金分红），合计分红金额约 2.50 亿元，占公司 2025 年合并报表归母净利润的比例为 29.31%。公司目前正处于快速发展期，业绩成长与各项战略布局持续需要资金支持。未来，公司将在经营情况、公司章程和分红政策允许的前提下，结合公司业务发展的状况和阶段，合理、积极地运用回购、现金分红等方式与投资者共享发展成果，以实际行动回馈股东，提升股东回报。</p> <p>Q2. 公司为什么要做金融衍生品套期保值业务？公司历史上的套期保值业务是否盈利？公司套期保值业务期限一般为多长？ A2: 公司开展金融衍生品套期保值业务，主要系公司采取风险中性的策略，根据公司日常经营情况，为有效降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用金融衍生品的套期保值功能，控制市场风险，并不以盈利为目的。公司历史套期保值业务收益较为平稳。公司套期保值业务期限通常不超过 12 个月。</p> <p>Q3 公司以简易程序向特定对象发行股票的资金用途是什么？</p>

	<p>A3: 本次股东会议案仅为提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，并不代表公司最终会实施该事项。如后续有相关计划，公司严格按照监管部门的相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、准确、真实和完整。</p> <p>Q4 请问公司港股上市进展如何？</p> <p>A4: 公司港股 IPO 相关工作目前正在有序推进中，公司将根据该事项的重大进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q5. 公司一季度利润率水平较高，如何看二季度及后续公司的盈利能力持续性？</p> <p>A5: 当前公司毛利率水平处于较高位置，后续毛利率水平和盈利能力需要持续关注价格的传导和成本的变动。从市场预期看，受益于 AI 应用及 Token 调用的需求爆发，后续产品价格仍有一定上升空间，且原厂已转向 2027 年及以后的产能锁定，公司也将持续关注后续的价格走势。在成本方面，公司存货采用移动加权平均法计价，整体成本的变化相对平滑。在产品价格方面，公司产品价格随行就市，产品价格的传导路径较为平顺。展望第二季度，行业景气度持续，公司业绩有望继续向好，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q6. 公司的库存水平及库存成本如何？</p> <p>A6: 截至 2026 年一季度末，公司的库存规模为 120.69 亿，相较 2025 年底增长 53.39%。在成本方面，公司存货采用移动加权平均法计价，每笔新采购入库时都会重新计算成本，由于是逐季采购，采购价会有所提升，成本会有所提高，整体成本的变化相对平滑。2026 年一季度末的公司库存成本相对于当前产品销售价格仍有较大优势，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q7. 公司未来 3-5 年的战略定位如何？</p> <p>A7: 公司整体战略规划主要是围绕“存储+先进封测”布局。在存储端，公司以全面的存储技术能力服务 AI 场景应用，覆盖主控芯片设计、介质研究与设计、解决方案研发以及先进封测等技术环节。通过这些技术布局，公司能够深度覆盖 AI 新兴端侧、企业级存储以及智能汽车等 AI 应用场景。公司坚持“研发封测一体化”的战略布局，持续增加产业链覆盖环节，提升产业链价值占比和产品附加值，不断提升公司行业竞争力和盈利稳定性。在先进封测端，公司通过先进封装技术打造生态链，覆盖 AI 硬件基础设施“存、算、运”三大核心领域：“存”是面向先进存储芯片的 FOMS（扇出型存储堆叠）系列，满足大容量、高密度存储需求；“算”是聚焦算力与存储融合的 CMC（存算芯粒）系列，适配存算合封的技术发展趋势；“运”是主攻高速信号传输的 OEC（光电共封装）系列，契合超高速互联的应用需求；三大产品线可全方位响应 AI 时代对存（大容量存储）、算（存算合封）、运（高速信号传输）的核心诉求。基于以上布局，公司将从存储解决方案供应商升级为 AI 时代“存储+先进封测”全栈技术服务商，为公司深耕 AI 产业链“存算运融合”领域构筑了坚实的长期竞争壁垒。相关进展请以公司正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
--	--

	<p>Q8. 公司先进封测的毛利率水平如何？ A8: 公司目前具备两大生产基地，包括位于惠州的泰来科技（存储器封测及 SiP 封测基地）及位于东莞的晶圆级先进封测制造基地。根据公司《2025 年年度报告》，2025 年公司对外提供先进封测服务的毛利率为 37.70%，该先进封测服务由泰来科技提供。公司位于东莞的晶圆级先进封测制造基地正按客户节奏稳步推进打样与验证工作，具体业绩情况请关注公司后续的相关公告。</p> <p>Q9. 公司具备哪些关键核心竞争力？ A9: 公司拥有“主控芯片 x 创新存储方案设计 x 先进封测”全栈技术能力。在主控芯片设计方面，公司积极布局芯片研发与设计领域，将采用业界领先的架构设计，提升公司在 AI 手机、AI 穿戴、AI 智驾等领域的高端存储解决方案的产品竞争力；在创新存储方案设计方面，公司紧抓 AI 发展浪潮，针对端侧、边缘端和云端推理等不同应用场景，构建了全面的存储解决方案体系，公司全面掌握了存储固件核心技术，有能力匹配各类客户典型应用场景，为客户提供创新、优质的存储解决方案；在先进封装方面，公司已掌握 16/32 层叠 Die、30~40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，并构建公司已构建覆盖了 2.5D、Chiplet、RDL、Fanout 等多种先进封装形式。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是全球唯一一家具备晶圆级封测能力的独立存储解决方案提供商。</p> <p>Q10. 公司认为存储缺货预计持续到什么时候？ A10: 本轮存储涨价由 AI 算力需求爆发引起，据市场观点，供需缺口在短期内难以缓解，存储市场有望持续景气。公司将持续跟踪未来存储行业的发展趋势，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q11. 公司除了 Meta 外，还有哪些核心大客户？ A11: 公司产品可应用于智能移动及 AI 新兴端侧、PC 及企业级存储、智能汽车及行业领域。公司的解决方案已服务于包括 Meta、Google、阿里、小米、OPPO、vivo、荣耀、传音、摩托罗拉、中兴、TCL、惠普、联想、宏碁、华硕、Positivo、比亚迪及长安等众多全球知名客户。</p> <p>Q12. 公司已经研发了 CXL 2.0 产品，请问 CXL 3.0 产品研发进度如何？ A12: 公司 CXL 3.0 产品正处于研发阶段，具体研发进度请以后续正式信息披露公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q13. 公司东莞晶圆级先进封测厂是否能提供 HBM 产品？ A13: 公司及子公司没有开发 HBM 产品，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q14. 能否介绍一下公司 Mini SSD 产品？ A14: 公司已量产 Mini SSD 产品，该产品尺寸仅为 15*17*1.4（mm），体积仅为传统 M.2 的 40%，能够在轻薄的形态下实现最高 2TB 的存储容量与 3700MB/s 读取速度、3400MB/s 写入速度的旗舰级性能，可满足掌上游戏机等小型设备对体积与性能兼顾的需求。该产品荣获入选《时代》周刊（《TIME》）发布的 2025 年“Best Inventions of the Year”（年度最佳发明）榜单，成为全球唯一上榜的</p>
--	--

	<p>存储产品，并在 CES 2026 斩获“TWICE Picks Awards”、Embedded World 2025 获得“Best-in-Show”大奖、MWC 2026 获得“Best-in-Show”奖、Edison Awards 2026 获得“爱迪生奖铜奖”。</p> <p>Q15. 公司二季度产品价格增长多少？ A15：根据 Trendforce 的预测，2026 年第二季度整体一般型 DRAM 合约价格仍将增长。NAND Flash 市场持续由 AI、数据中心需求主导，全产品线连锁涨价的效应不减，预计第二季度整体合约价格仍将增长。公司产品主要为 TO B 客户销售，产品价格随行就市。</p> <p>Q16. 如何看原材料涨价后对公司利润的影响？ A16：当前公司毛利率水平处于较高位置，后续毛利率水平和盈利能力需要持续关注价格的传导和成本的变动。从市场预期看，受益于 AI 应用及 Token 调用的需求爆发，后续产品价格仍有一定上升空间，且原厂已转向 2027 年及以后的产能锁定，公司也将持续关注后续的价格走势。在成本方面，公司存货采用移动加权平均法计价，每笔新采购入库时都会重新计算成本，由于是逐季采购，采购价会有所提升，成本会有所提高，整体成本的变化相对平滑。2026 年一季度末的公司库存成本相对于当前产品销售价格仍有较大优势，因此当前毛利率处于较高水平。在产品价格方面，公司产品价格随行就市，从当前时点来看，产品价格的传导路径较为平顺。</p> <p>Q17. 公司晶圆级项目预计什么时候能够贡献收入？ A17：公司位于东莞松山湖的晶圆级先进封测制造项目进展顺利，正按客户节奏稳步推进打样与验证工作。如果客户导入顺利，预计将于 2026 年年底起正式贡献收入。通过该项目，公司将为客户交付“存储+晶圆级先进封测”一站式综合解决方案，进一步强化在存算融合领域的技术壁垒与市场竞争力，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q18. 公司在优秀人才储备、吸纳人才方面有什么举措？ A18：公司高度重视人才队伍建设，已逐步建立健全员工考核奖励、科技人员培养进修、职工技能培训、优秀人才引进制度，并采取股权激励措施，充分调动公司员工的工作积极性，释放工作潜力，提高创新能力。公司在 2023 年、2024 年、2025 年均制定了限制性股票激励计划，将进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，且有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。</p>
附件清单	见附件
日期	2026 年 5 月 7 日、2026 年 5 月 12 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。

附件：

序号	公司名称	姓名
1	NHIS	Cao Tiejun
2	NHIS	Park Sangho
3	NH-Amundi Asset Management	Kim Hyung Gyun
4	NH-Amundi Asset Management	Lee Kyu
5	Kiwoom Asset Management	Cho Kyungtaek
6	The Korean Teachers' Credit Union	Heo Ji-yeon
7	The Korean Teachers' Credit Union	Park Jong-hyuk
8	Asset Plus Investment	Max Lee
9	法诺新能源汽车	张连强
10	凯新达电子	徐成
11	越竞科技	洪宾
12	赋创投资	刘一颖
13	毅臻基金	童义真
14	深圳创投公会	蒋玉才
15	大为股份	何强
16	光远投资	黄翌昕
17	卓弘电子	钟源波
18	极创界	周宁宁
19	港信科技	涂明波
20	越竞科技	方平凡
21	梧桐资本	林宁珠
22	中汇控股	陈一辰
23	大族数控	朱学炜
24	中国电信	叶震彪
25	创融通投资	曾晓龙
26	泽辉资本	邱雨菲
27	泽辉资本	袁陈杰
28	梧桐资本	王翼
29	穗圆科技	麦苗
30	华杉投资	廖鹏展
31	华杉投资	段永强
32	华杉投资	HISON LAM
33	方圆鑫基金	朱易蓉